

EM2021AHF-L

水溶性助焊剂

产品描述

EM2021AHF-L 是一种无卤素*，有机酸型水溶性助焊剂。**EM2021AHF-L** 可在水中彻底的清洗以达到很低的离子含量，同时产生的表面具有很高的表面绝缘电阻。此助焊剂被特殊配制，使用于微电子和 DIP 封装的引线镀锡涂层的浸焊或波峰焊。

益处

- * 优良的活性水平
- * 可清洗达到低离子水平
- * 无腐蚀性的卤化物
- * 高可靠性

物理性质和可靠性数据

物理性质和可靠性数据	规格	测试方法	结果 (典型的)
助焊剂类型	-	-	无卤素* 有机水溶性
等级类型	查阅 J-STD-004	-	ORH0
颜色和外观	-	-	淡黄色 液体
气味	-	-	醇样气味
闪点 (开口)	-	-	18 °C
比重(@25°C	-	-	0.875 ± 0.005
含固量	-	J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.3.34	21.0 ± 2.0 %
卤化物含量 (%) (氯化物和溴化物)	Max 0.0%	JIS Z 3197, Method 8.1.4.2.1	0.00 %
pH (5%溶液)	-	-	4
腐蚀测试	主要腐蚀可接受	J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.6.15	高
表面绝缘阻抗(典型的) 85°C / 85% RH 168 小时	Min 1 x 10 ⁸ Ω	J-STD-004, IPC-TM-650, Method 2.6.3.3	≥ 1 X 10 ¹¹ Ω 水洗后

*无卤素要求规范依照标准 IPC 4101B, IEC 61249-2-21 和 JPCA-ES01

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用。

操作

EM2021AHF-L 在集成电路原料，像合金 42、镍、铜和其合金上，提供优良的湿润性。为了获得良好的焊接成果，可设置预热装置，使元件套件在波峰前的温度达到(120-130)°。镀锡之后的残留物可使用凉水移除。最后使用去离子水清洗可获得较低的离子水平。

稀释

EM2021AHF-L 在正常工作状态下会有少许蒸发，为了保持其原始浓度，应采用稀释方法。

包装

25 litres 一桶或 200 litres 一桶。

贮存

EM2021AHF-L 助焊剂是含有醇类成分的易燃品，须避火保存。

健康和安全

在安全和健康问题上，请参考材料安全数据表。

在此宣传册里的信息和声明均是可信的，但我公司不承担任何担保和陈述上的责任。为确保这里的任何信息和产品对各自目的的适用性，用户需要做出充分的认证和测试来测定。没有任何针对特别目的的适合性可以担保。所运用所有产品特性都是象征性的，不可以作为规格使用。